



2007-2008 年中国 IC 卡/ 智能卡产业与市场研究报告

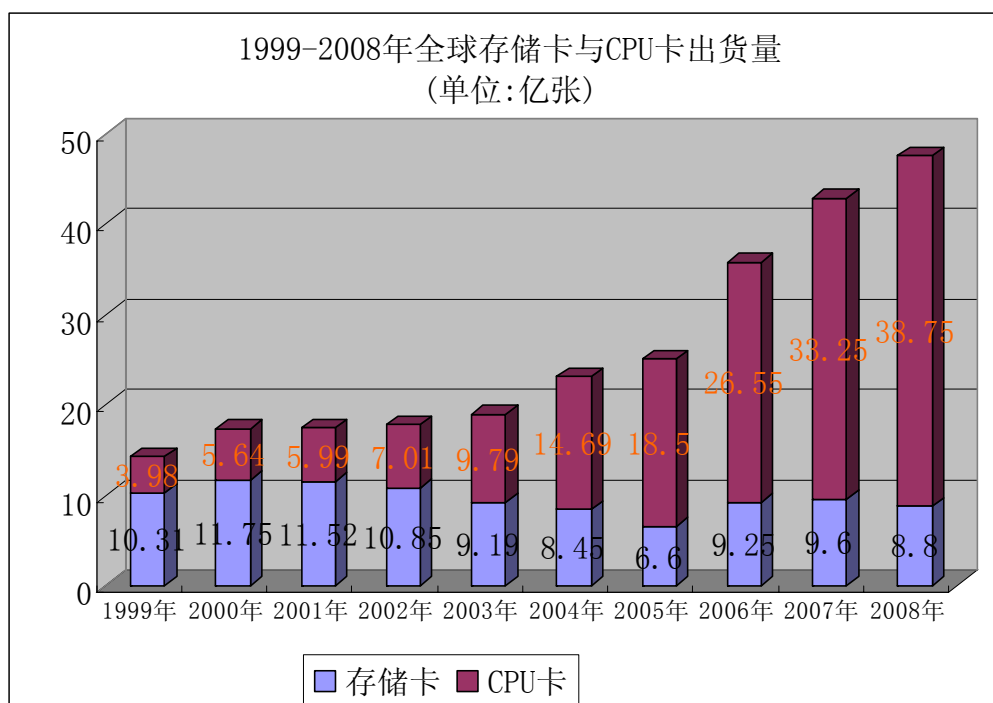
版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

序号	C208	报告名称	2007-2008年中国 IC 卡/智能卡产业与市场研究报告				
字数	7万	图表数量	101	报告页数	170	完成时间	2008年1月
语种	中文	电子版价格(RMB)	9500		纸质版价格(RMB)	8500	

摘要

本报告重点对中国 IC 卡市场状况及发展进行了描述与分析预测，并详细研究了全球重要的 6 家 IC 卡芯片供应商以及近 50 家中国 IC 卡芯片、COS、卡封装厂商和 IC 卡相关设备厂商。

根据 Eurosmart 于 2007 年 11 月估测，2007 年全球 SIM 卡出货将达到 30.4 亿张，比 2006 年增长 20%，这一数字高于年初的预测，主要是因为发展中国家移动运营商的需求超过预期，全球最大的网络运营商中国移动前三季度订货超过 2.8 亿美元，比上年同期增长 60%。。

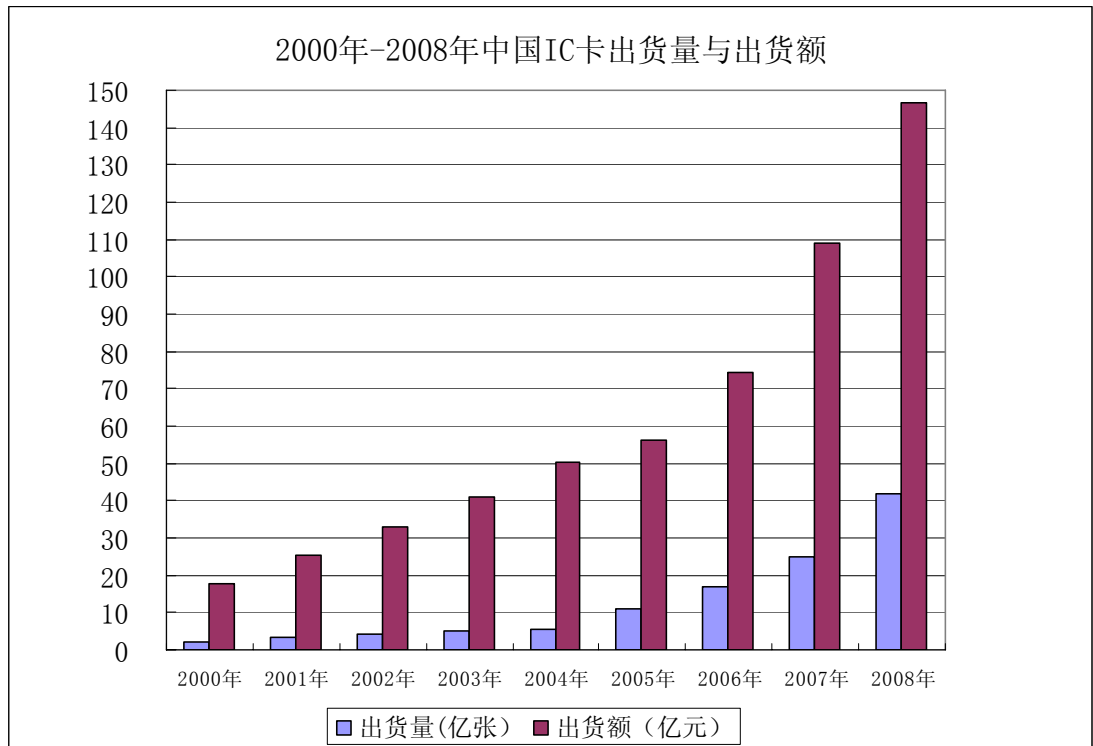


数据来源: Eurosmart 水清木华研究中心整理

由上图可以看出，全球 IC 卡在总体出货量增长的同时，CPU 卡所占的比重也在不断上升，而存储卡的出货量却在逐年下降，存储卡的出货量在 2006 年与 2007 年的上升是由于 Eurosmart 从 2006 年开始在统计与预测中包含了中国的第二代身份证项目和公交卡项目。

根据中国信息产业商会智能卡专业委员会对中国 IC 卡市场出货量的统计，2005 年中国 IC 卡市场出货量约 10.80 亿张，比 2004 年增长了 91.8%，出货额却只增长了 11.1%，为 56.07 亿元。2006 年中国 IC 卡市场出货量约 16.76 亿张，比 2005 年增长了 55.2%，出货额却只增长了 32.4%，为 74.26 亿元。这是由于近年来中国 IC 卡市场竞争加剧，价格下滑，尤其是 SIM 卡的价格大幅下落造成的。

水清木华研究中心利用中国信息产业商会智能卡专业委员会的历史数据，运用时间序列法，并综合考虑信息产业部金卡工程对第二代身份证发放与银行卡 EMV 迁移的计划，以及 2008 年奥运会的举行等因素，对 2007 年至 2008 年中国 IC 卡出货量与出货额进行了估算与预测，2006 年，中国 IC 卡的出货量与出货将货分别达到 16.76 亿张和 74.26 亿元。到 2008 年中国 IC 卡出货量将增长到 41.83 亿张，比 2006 年增长 1.50 倍，而出货额将达到 146.56 亿元，比 2006 年提高 0.97 倍。



来源：中国信息产业商会智能卡专业委员会 水清木华研究中心整理并预测

目前在重要的 IC 卡市场，基本由芯片供应商英飞凌等 6 家国际半导体巨头主导。Frost & Sullivan 公布的研究结果显示，2006 年，英飞凌在全球规模达 19 亿美元的 IC 卡芯片市场上占有 29.1% 的份额，遥遥领先于其他所有竞争对手。接下来是三星、NXP、Atmel、Renesas 和 STMicroelectronics，这 6 家厂商就占据了 91.3% 的份额。目前中国大部分的芯片市场国际依赖性仍然严重，IC 卡市场也不例外，国内 IC 设计公司所占的市场份额不高。

2006 年和 2007 年中国 IC 卡行业内的企业变革处于活跃期，纵横交叉的重组并购和新企业进入并存，从二代证、电信市场得以壮大的大公司日益加快向其他市场拓展的步伐，此外，进军国外市场成为这些企业的重点工作。多年来 IC 卡企业面临产品同质化的问题仍继续存在，产品同质带来的是价格的持续走低，但是这种情况又不能根本改善，因此，未来的竞争焦点就集中到了企业的低成本上。

正文
目录

第一章 IC 卡及其相关知识
1.1 IC 卡定义

1.2IC 卡分类
1.3 无线射频识别技术 RFID
1.4 IC 卡安全机制综述
1.5 IC 卡国际标准
1.5.1 接触式 IC 卡标准 ISO 7816
1.5.2 非接触式 IC 卡标准
1.6 金卡工程
1.7 IC 卡质量监督检验机构
1.8 全球 IC 卡联盟
1.8.1 亚太地区 IC 卡协会 (APSCA)
1.8.2 欧洲 IC 卡行业协会 (EuroSmart)
1.8.3 欧洲 SIM 卡联盟机构(Radicchio)
1.8.4 美国 IC 卡联盟 (SCA)
第二章 EMV 磁卡转智能卡发展现状
2.1 EMV 标准
2.2 国际 EMV 迁移的背景及现状
2.2.1 国际 EMV 迁移的背景
2.2.2 EMV 迁移方式
2.2.3 国际 EMV 迁移现状
2.2.3.1 欧洲
2.2.3.2 亚太地区
2.2.3.3 美国和其他地区
2.3 中国 EMV 迁移背景、标准与计划
2.3.2 中国银行卡 EMV 迁移的初步计划
2.4 中国银行卡 EMV 迁移现状
2.4.1 中国建成 EMV 国际授权检测实验室
2.4.2 银联全面启动 EMV 迁移
2.4.3 工商银行智能卡研发与 EMV 迁移
2.4.4 农业银行改造系统迎战 EMV 迁移
2.4.5 中国银行的 EMV 迁移策略
2.4.6 建设银行 IC 卡发行与 EMV 迁移思路
2.4.7 中国首个试点 EMV 迁移城市—上海
2.4.8 北京 EMV 迁移试点工作启动
第三章 IC 卡市场状况与发展
3.1 全球 IC 卡市场现状与前景
3.2 中国 IC 卡市场现状与发展
3.2.1 中国 IC 卡市场整体出货情况与发展
3.2.2 中国 IC 卡发行情况与发展
3.3 中国电信 IC 卡市场现状与前景
3.3.1 移动电话卡市场
3.3.2 国内企业在中国移动电话卡的市占率不断增长速度

- 3.3.3 USIM 卡将成为新的市场亮点
- 3.3.4 衰退中的公用电话 IC 卡
- 3.3.5 小灵通机卡分离—PIM 卡市场
- 3.4 中国非电信 IC 卡市场现状与前景
 - 3.4.1 第二代身份证
 - 3.4.2 交通卡
 - 3.4.3 社保卡
 - 3.4.4 教育领域 IC 卡的发展
 - 3.4.5 税控卡与税控机
 - 3.4.6 其他应用领域
- 3.5 中国 IC 卡行业竞争格局
 - 3.5.1 中国 IC 卡行业发展状况
 - 3.5.2 中国 IC 卡价格趋势
 - 3.5.3 中国 IC 卡市场销售渠道
 - 3.5.4 中国智能卡十强企业

第四章 IC 卡上游产业研究

- 4.1 IC 卡发行流程
- 4.2 IC 卡产业链简介
- 4.3 IC 卡上游芯片产业格局
- 4.4 国际 IC 卡上游厂家研究
 - 4.4.1 英飞凌
 - 4.4.2 ATMEL
 - 4.4.3 三星
 - 4.4.4 意法半导体
 - 4.4.5 瑞萨
 - 4.4.6 NXP (恩智浦半导体)

第五章 中国 IC 卡芯片厂商研究

- 5.1 大唐微电子技术公司
 - 5.1.1 公司介绍
 - 5.1.2 财务业绩
 - 5.1.3 大唐微电子 IC 产品领域
- 5.2 上海复旦微电子股份公司
 - 5.2.1 公司介绍
 - 5.2.2 财务状况
- 5.3 上海华虹集团有限公司
 - 5.3.1 公司介绍
 - 5.3.2 上海华虹计通智能卡系统有限公司
 - 5.3.3 上海华虹集成电路有限责任公司
 - 5.3.4 北京华虹集成电路有限责任公司
- 5.4 同方微电子
 - 5.4.1 公司介绍

5.4.2 近期经营概述
5.5 上海贝岭
5.5.1 公司介绍
5.5.2 经营情况
5.5.3 上海贝岭客户群
5.6 北京中电华大电子
5.6.1 公司介绍
5.6.2 近期财务数据
5.6.3 各应用领域智能卡产品情况
5.6.4 三大战略部署
第六章 中国 IC 卡制卡厂商研究
6.1 金雅拓
6.1.1 公司简介
6.1.2 营收情况
6.1.3 相关中国合资公司
6.2 握奇数据
6.2.1 公司介绍
6.2.2 营收情况
6.2.3 海外布局
6.2.4 国内大客户策略
6.2.5 产品应用项目
6.3 天津杰普智能卡
6.3.1 公司介绍
6.3.2 产品情况
6.3.3 公司客户
6.5 金邦达宝嘉集团有限公司
6.5.1 公司简介
6.5.2 客户关系
6.5.3 合作伙伴
6.6 精工伟达科技(深圳)有限公司
6.6.1 公司简介
6.6.2 合作伙伴
6.6.3 客户关系
6.7 北京航天智通科技有限公司
6.7.1 公司简介
6.7.2 产品简介
6.7.3 合作伙伴
6.9 中山市达华智能科技有限公司
6.9.1 公司介绍
6.9.2 产品情况
6.10 深圳明华澳汉科技
6.10.1 公司简介

- 6.10.2 生产规模
- 6.10.3 竞争优势
- 6.10.4 财务状况
- 6.10.5 合作伙伴
- 6.11 上海索立克智能卡有限公司
- 6.11.1 公司简介
- 6.11.2 生产条件
- 6.12 上海飞乐音响股份有限公司
- 6.12.1 公司简介
- 6.12 上海长丰智能卡有限公司
- 6.12.3 上海浦江智能卡系统有限公司
- 6.12.4 产品简介
- 6.12.3 财务状况
- 6.13 上海中卡集团
- 6.14 深圳市清华茂物信息技术有限公司
- 6.14.1 公司简介
- 6.14.2 制卡分公司
- 6.14.4 产品介绍
- 6.15 珠海东信和平智能卡股份有限公司
- 6.15.1 公司简介
- 6.15.2 产品情况
- 6.15.3 海外市场
- 6.15.2 经营情况
- 6.16 航天信息股份有限公司
- 6.16.1 公司简介
- 6.16.2 承担项目
- 6.16.3 生产基地
- 6.16.4 经营情况
- 6.17 中电智能卡公司
- 6.17.1 公司简介
- 6.17.2 产品情况
- 6.18 武汉天喻信息
- 6.19 深圳市宏卡科技
- 6.19.1 公司简介
- 6.19.2 客户
- 6.19.3 合作伙伴

第七章 中国 IC 卡系统解决方案及相关软件厂商研究

- 7.1 北京飞天诚信科技有限公司
- 7.1.1 公司简介
- 7.1.2 海外市场开拓
- 7.2 深圳华深达实智能科技有限公司
- 7.2.1 公司简介

- 7.2.2 产品资质:
- 7.3 福建新大陆电脑股份有限公司
 - 7.3.1 公司简介
 - 7.3.2 经营状况
- 7.4 广东德生科技有限公司
 - 7.4.1 公司简介
 - 7.4.2 生产规模
 - 7.4.3 各应用产品经营情况
- 7.4.2 产品简介
- 7.4.5 合作伙伴
- 7.5 北京东方英卡数字信息技术有限公司
 - 7.5.1 公司简介
 - 7.5.2 主要客户
- 7.6 北京硕良信息技术有限公司
 - 7.6.1 公司简介
 - 7.6.2 合作伙伴
- 7.7 大连恒基电子技术有限公司
 - 7.7.1 公司简介
 - 7.7.2 产品介绍
- 7.8 江苏恒宝股份有限公司
 - 7.8.1 公司简介
 - 7.8.2 生产设备
 - 7.8.3 主营业务分析
 - 7.8.3 主要客户
- 7.9 海南太平洋智能技术有限公司
- 7.10 北京九鼎安通

第八章 中国 IC 卡读写设备厂商研究

- 8.1 芙蓉电子
 - 8.1.1 公司介绍
 - 8.1.2 产品情况
- 8.2 北京昌贸技术有限公司
 - 8.2.1 公司介绍
 - 8.2.3 产品情况
- 8.4 福建联迪商用设备有限公司
- 8.5 深圳华视

第九章 中国 IC 卡片材/印刷等厂商

- 9.1 江苏华信塑业发展有限公司
- 9.2 陕西中财科技企业集团有限公司
- 9.3 伊诺尔集团
 - 9.3.1 上海伊诺尔信息技术有限公司
 - 9.3.2 上海伊利时印刷有限公司

	<p>9.4 郑州万光智能卡科技有限公司</p> <p>9.4.1 公司介绍</p> <p>9.4.2 工厂情况</p>
<p>图表 目录</p>	<p>图目录</p> <p>图 1-1 接触式 CPU 卡芯片结构图</p> <p>图 1-2 IC 卡分类</p> <p>图 2-1 2004 年底-2006 年年底全球 EMV 卡累计发卡量</p> <p>图 2-2 2004 年底-2006 年年底全球 EMV 受理终端累计数量</p> <p>图 3-1 1999-2008 年全球各类 IC 卡出货量</p> <p>图 3-2 2000 年-2008 年中国 IC 卡出货量与出货额</p> <p>图 3-3 1996-2008 年中国 IC 卡发行量</p> <p>图 3-4 2001-2006 年中国 IC 卡各主要应用领域累计发卡量</p> <p>图 3-5 2001-2006 年中国 IC 卡各主要应用领域累计发卡比例</p> <p>图 3-6 2006 年中国各类应用 IC 卡出货量</p> <p>图 3-7 2006 年中国各类应用 IC 卡市场份额(按出货量)</p> <p>图 3-8 2001 年-2006 年中国移动电话卡出货量与发行量</p> <p>图 3-9 2004-2006 年中国移动电话卡国内外企业市占率</p> <p>图 3-10 2006-2010 年中国 3G 手机用户数</p> <p>图 3-11 2001-2006 年中国公用电话卡发行量</p> <p>图 3-12 2004-2008 年中国二代证发行量</p> <p>图 3-13 2001-2006 年中国交通 IC 卡发行量</p> <p>图 3-14 2001 年-2006 年中国各类型社保卡发行量</p> <p>图 3-15 2001-2006 年中国社会保障 IC 卡发行量</p> <p>图 3-16 2001-2006 年中国教育领域 IC 卡发行量</p> <p>图 4-1 IC 卡产业链</p> <p>图 4-2 2006 年全球 IC 卡芯片厂商市占率(销售额)</p> <p>图 4-3 2005-2010 年全球 IC 卡用微控制器销售量</p> <p>图 4-4 2003-2007 年英飞凌净销售收入</p>

- 图 4-5 Atmel 公司 2000-2006 年营业收入和经营利润统计图
- 图 4-6 Atmel 四个事业部 2006 年营业收入比例统计图。
- 图 4-7 2004-2006 年三星电子半导体事业部销售收入与利润
- 图 4-8 意法半导体 2007 年第三季度分高市场营收结构
- 图 4-9 意法半导体 IC 卡金融系统产品路线图
- 图 4-10 意法半导体 IC 卡电子政务领域产品路线图
- 图 4-11 意法半导体 IC 卡移动通讯 SoC 产品路线图
- 图 4-12 意法半导体 IC 卡内容产品领域产品路线图
- 图 4-13 瑞萨各应用领域 MCP 全球市场份额
- 图 4-14 瑞萨全球智能卡生产网络
- 图 4-15 瑞萨中国安全 MCU 事业的目标
- 图 4-16 瑞萨在中国的智能卡合作伙伴
- 图 4-17 瑞萨智能卡产品技术规划图
- 图 4-18 瑞萨移动通信产品一览
- 图 4-19 瑞萨金融 ID 卡用产品一览
- 图 4-20 瑞萨双模/非接触产品规划图
- 图 4-21 2006 年 NXP 销售额全球各地区比例
- 图 5-1 2004-2006 年大唐微电子销售收入与净利润
- 图 5-2 2004-2007 年前三季复旦微电子销售收入与毛利
- 图 5-3 2004-2007 年前三季上海贝岭主营业务收入与利润总额
- 图 5-4 2006 年上海贝岭各应用 IC 卡销售量
- 图 6-1 2007 年第三季度金雅拓各类应用产品收入及比重
- 图 6-2 2007 年第三季度金雅拓各地区收入及比重
- 图 6-3 2006 年 Q3-2007 年 Q2 金雅拓 SIM 卡产品 ASP 降幅
- 图 6-4 金雅拓客户一览
- 图 6-5 2003-2006 年握奇数据营业收入
- 图 6-6 2004-2006 年握奇数据发卡量
- 图 6-7 2002-2006H1 飞乐音响主营业务收入
- 图 6-8 2002-2007 年前三季东信和平主营业务收入

图 6-9 2004-2007 年上半年航天信息主营收入及利润
图 6-10 中电智能卡投资方结构
图 6-11 深圳宏卡科技部分客户
图 7-1 2002-2007 年前三季新大陆电脑主营业务收入
表目录
表 2-1 EMV Level 1 与 EMV Level 2 认证规范内容
表 2-2 各方应对 EMV 认证的措施
表 2-3 2006 年底全球各区域 EMV 迁移情况表
表 2-4 2006 年底欧洲部分国家 EMV 迁移情况的比较
表 2-5 亚太区各国家/地区三个梯队 EMV 进展情况
表 2-6 《中国金融集成电路 (IC) 卡规范》(V2.0) 之 10 部分内容
表 3-1 2006-2008 年全球各应用领域分类型 IC 卡出货量
表 3-2 2007 年全球各应用领域非接触 IC 卡出货量
表 4-1 2001-2006 年 Atmel 智能卡芯片按出货量与销售额全球市场占有率统计
表 4-2 2006-2008 年各季度三星电子系统 LSI 部门营业收入、利润及利润率
表 4-3 意法半导体 2007 年第三季度季度分产品组营收对比
表 4-4 瑞萨智能卡产品全球与中国累计发货量
表 4-5 瑞萨提供给中国的智能卡项目产品
表 5-1 大唐微电子概况
表 5-2 大唐微电子在中国 IC 行业的业绩
表 5-3 公司的 IC 卡发展历程
表 5-4 大唐微电子 IC 卡产能情况
表 5-5 大唐微电子 IC 卡行业地位
表 5-6 大唐微电子 IC 卡产品及其类型
表 5-7 华虹计通智能卡系统有限公司主要产品
表 5-8 上海华虹集成电路有限责任公司主要产品介绍
表 5-9 上海华虹集成电路有限责任公司产品区域代理
表 5-10 北京华虹产品类型及其型号

表 6-1 握奇数据主要产品及其应用项目列表
表 6-2 精工伟达科技客户
表 6-3 航天智通科技产品
表 6-4 2005-2007 年前三季明华澳汉科技分产品销售额及毛利
表 6-5 上海长丰智能卡 2005 年与 2006 年资产规模和净利润
表 6-6 上海浦江智能卡系统 2005 年与 2006 年资产规模和净利润
表 6-7 上海浦江智能卡系统公司年生产能力
表 6-8 浦江客户部分名单
表 6-9 2005-2007 上半年飞乐音响“IC 卡及相关软件开发和系统集成”业务收入与利润率
表 6-10 深圳清华茂物产品
表 6-11 2006 年与 2007 年上半年东信和平分产品主营业务收入及利润率
表 6-12 2007 年上半年航天信息分产品营业收入与毛利率
表 6-13 中电智能卡公司概况及产能
表 7-1 2007 年上半年新大洲电脑分产品主营业务收入与利润率
表 7-2 德生科技 IC 卡产品所采用芯片厂商
表 7-3 德生科技接触式 IC 卡产品所用芯片型号一览表
表 7-4 德生科技感应式 IC 卡产品所用芯片型号一览表
表 7-5 德生科技 CPU 卡产品规格一览表
表 7-6 东方英卡主要客户与对应产品
表 7-7 大连恒基电子产品
表 7-8 2003-2007 上半年恒宝股份分产品主营业务收入和毛利率

如何申请购买报告

1、请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2、研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3、会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4、研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563

传真: 86-10-82601570